

DFMEA

開發案號(R/RD)		R25024		制表日期					修訂日期					版次				頁數											
案件名稱		單機版薄膜指紋KPL-方型(THD)																產品別		G鎖									
結構分析			功能分析			失效分析				風險分析				DFMEA 優化															
1.上一級或較高級別	2.關鍵因素	3.下一級或較低級別特性	1.上一級或較高級別功能及要求	2.關鍵因素功能及要求	3.下一級或較低級別功能及要求或特性	1.失效影響(FE)	嚴重度S	2.關鍵因素的失效模式(FM)	3.工作要因或的失效原因(FC)	失效原因/失效模式的預防措施(PC)	發生度O	失效原因/失效模式的偵測措施(DC)	難檢度D	RPN	預防措施	偵測措施	預定完成日	執行單位	改善結果S	改善結果O	改善結果D	改善結果PRN							
內外側總組合	外側總組合	外側防水墊圈	內外側總組合	外側總組合	防水墊圈	外側基板鉗點銹蝕	8	雨水從防水墊圈與裝飾板頂端縫隙滲入流到基板造成短路	防水墊圈與裝飾板壓合區域厚度尺寸縮水變形	防水墊圈壓合區域厚度設為重點尺寸	3	查檢表需與圖面相符	3	72															
內外側總組合	外側總組合	裝飾板	內外側總組合	外側總組合	裝飾板	外側基板鉗點銹蝕	8	雨水累積於裝飾板內側，因排水不良造成基板短路	裝飾板排水設計不良，造成部份肋部會累積雨水	裝飾板內部肋條設計不可過高及增加拔模角，使水份可以導出	3	EVT進行雨水測試	3	72															
外側總組合	薄膜按鍵組合	薄膜按鍵	外側總組合	薄膜按鍵組合、基板	隔離板	按鍵PAD未對齊薄膜字體	8	調整隔離板與外側基板組裝後餘隙公差範圍	EVT組裝測試	3D圖面繪製時核對相關位置	3	EVT組裝時確認	3	72															

部主管

吳文發

課主管

黃福志

承辦人

邱建智

備註：S、O、D評分級距：10~1(高→低)。

WI-K-RD-12-F06